

NO.:	G3363-0110	VERSION:	B	PAGE:	1
------	------------	----------	----------	-------	---

晶圓廠 ADE 校驗操作程序

壹、目的

貳、適用時機

參、注意事項

肆、操作步驟

伍、生效與修訂

NO.:	G3363-0110	VERSION:	B	PAGE:	2
------	------------	----------	---	-------	---

晶圓廠 ADE 校驗操作程序

壹、目的：

使機台維持量測準確度。

貳、適用時機：

1. 每年2月、7月各校驗一次。
2. 機台量測值有誤差時。

參、注意事項：

1. ELEVATOR 移動尚未停止時勿拿起CASSETTE。
2. 上下貨時請勿碰觸到傳送手臂。
3. 使用托盤時不可急托、拉。

肆、操作步驟：

1. 先用標準片量測，以手動旋轉THICKNESS鈕將量測讀值調整與標準片標示厚度相同。
2. 拿一片WAFER使用研磨機研磨14.5MIL。
3. 研磨過後的14.5MIL WAFER以游標卡尺量測上下左右4點的厚度，並將厚度標示於WAFER上。
4. 將標示厚度的14.5MIL WAFER放於ADE機台上量測，量測WAFER上下左右4點的厚度。
5. 量測出來的厚度讀值與標示WAFER上的厚度值進行比較
 - 5.1 無誤差則跳至 (6.) 步驟。
 - 5.2 有誤差則調整 ADE GAN 的 VR 鈕，旋轉 GAN的VR 鈕時讀值會改變，將讀值調整與 WAFER上標示的厚度相同。
6. WAFER傳出校驗完成

伍、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。